



株式会社UKCホールディングス 2012年(平成24年)3月期 第3四半期決算説明資料

2012年2月8日



株式会社 UKCホールディングス





目次

事業セグメント	3
2012年3月期 第3四半期 ハイライト	4
2012年3月期 第3四半期 半導体及び電子部品事業	5
2012年3月期 第3四半期 電子機器事業	6
2012年3月期 第3四半期 システム機器事業	7
2012年3月期 第3四半期 財政状態(バランスシート)	8
2012年3月期 第3四半期 財政状態(キャッシュ・フロー)	9
2012年3月期 通期連結業績予想	10



事業セグメント



事業部門(セグメント)		主要製品
半導体及び 電子部品事業	半導体	イメージセンサー、メモリー、マイコン、システムLSI、 その他半導体
	電子部品	液晶パネル、バッテリー、光学ピックアップ、ACF※、基板、 タッチパネル、複合部品、その他一般電子部品
	EMS	電子機器受託製造サービス(Electronic Manufacturing Service)
	その他	LED照明
電子機器事業	電子機器	各種VTR、カメラ、ビデオプリンター、音響映像関連機器
	記録媒体品	磁気テープ、光ディスク、データ記録用ディスク
	製品	電子機器を組み合わせたシステム製品、セキュリティ関連製品
	その他	電子機器の修理、AV機器のレンタル、教育用ソフトウェア
システム機器事業	産業電子機器及び 伝送端末機器	非接触ICカード (FeliCa) R/Wモジュール、 リモコン電子キーシステム、医療用監視システム、 セキュリティシステム
	その他	信頼性試験受託業務、環境物質分析受託業務

※ 異方性導電膜 (Anisotropic Conductive Film):

中・小型液晶パネルとフレキシブルプリント基板を接合するフィルム型の実装材料



2012年3月期 第3四半期 ハイライト

(単位:百万円)	2011年3月期3Q累計		2012年3月期3Q累計		前年同期比	
	金額	構成	金額	構成	増減金額	増減率
売上高	228,822	100.0%	193,251	100.0%	▲35,571	▲15.5%
売上総利益	12,175	5.3%	12,202	6.3%	+27	+0.2%
SGA	8,781	3.8%	8,526	4.4%	▲254	▲2.9%
営業利益	3,394	1.5%	3,676	1.9%	+281	+8.3%
経常利益	2,947	1.3%	3,235	1.7%	+287	+9.8%
四半期純利益	1,978	0.9%	1,717	0.9%	▲260	▲13.2%

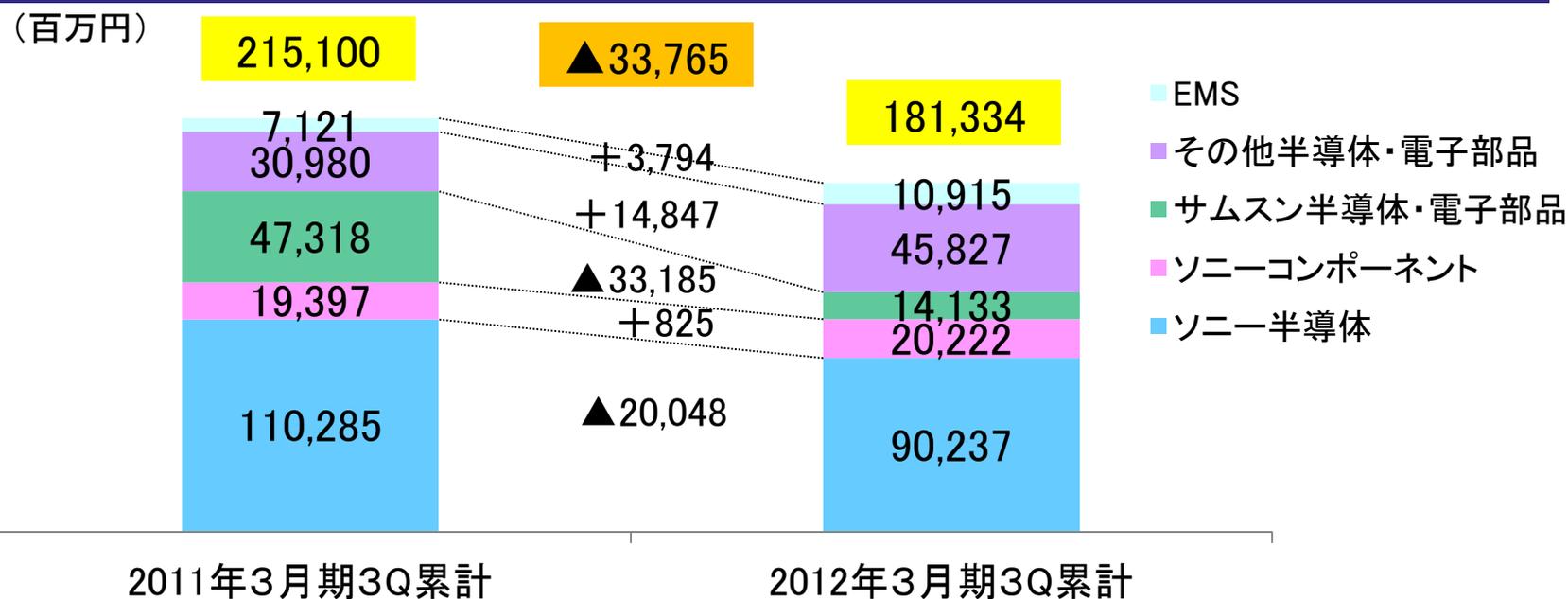
➤ 売上高: 前年比 ▲355億円(▲15.5%)

サムスン製半導体・電子部品ビジネスの事業譲渡の影響(▲331億円)、震災やタイ洪水の影響による主にデジタルスチルカメラ向けの半導体・電子部品売上の減少等の減収をスマートフォン向け電子部品販売やLED照明事業の増収が一部カバー

➤ スマートフォン向けタッチパネルやLED照明等の高付加価値商材の売上比率が拡大したことにより、売上総利益率は前年比で1%上昇。その結果、売上高は減少したものの、売上総利益は前年比微増。事業譲渡に伴うSGAの減少及び為替差損の改善で、営業利益、経常利益は前年比増

➤ 厚生年金基金脱退特別掛金(481百万円)等の事業会社統合費用や税制改正等に伴う税金費用の増加等により、四半期純利益は前年比 ▲260百万円(▲13.2%)

2012年3月期 第3四半期 半導体及び電子部品事業



セグメント利益(百万円)

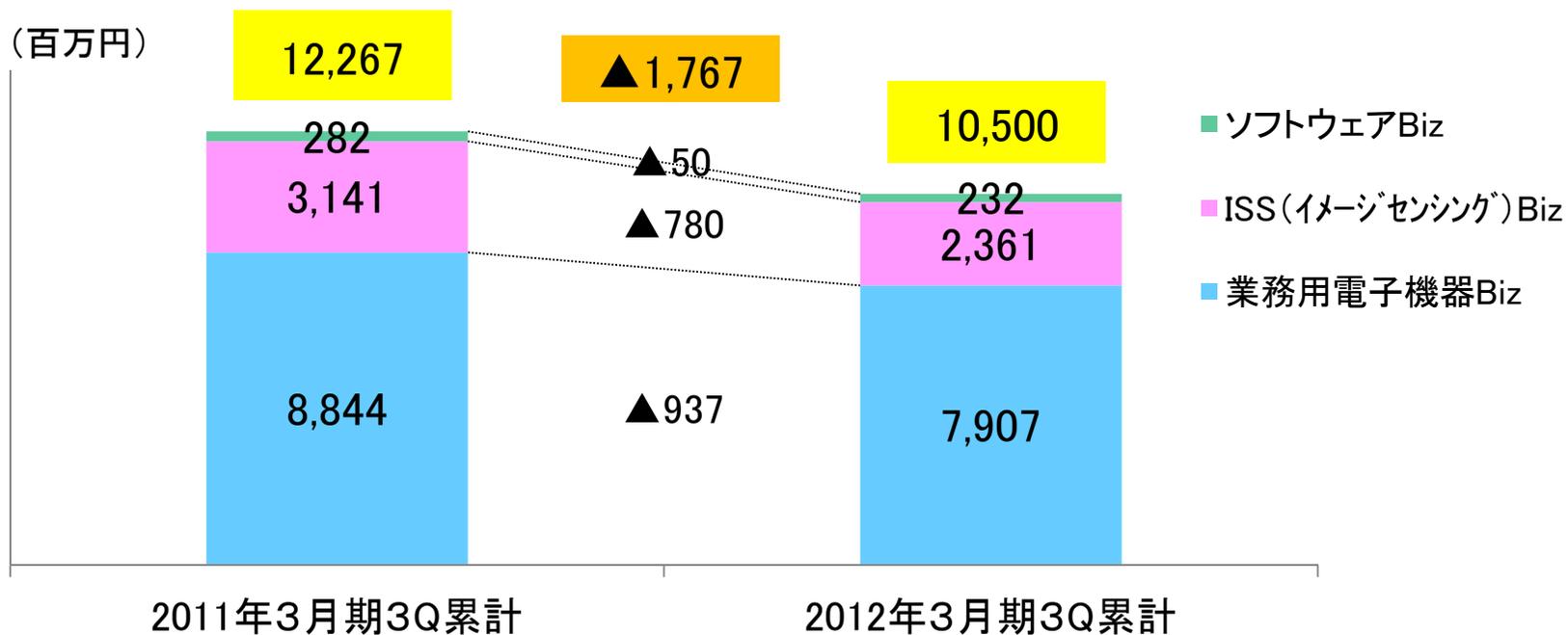
4,601

4,978

- ソニー半導体、電子部品：上期の震災影響に加えて、タイ洪水の影響による商材の調達難と顧客の生産減により、売上減少
- サムスン半導体、電子部品：7月に丸文セミコンへ事業譲渡
- その他：スマートフォン向けタッチパネル、車載向け液晶パネルが好調に推移。サムスンLED社製LED照明ビジネス、中国EMS自社工場の液晶モジュール基板実装受託も貢献
- 高付加価値商材の売上割合が拡大したことにより、セグメント利益は前年比増



2012年3月期 第3四半期 電子機器事業



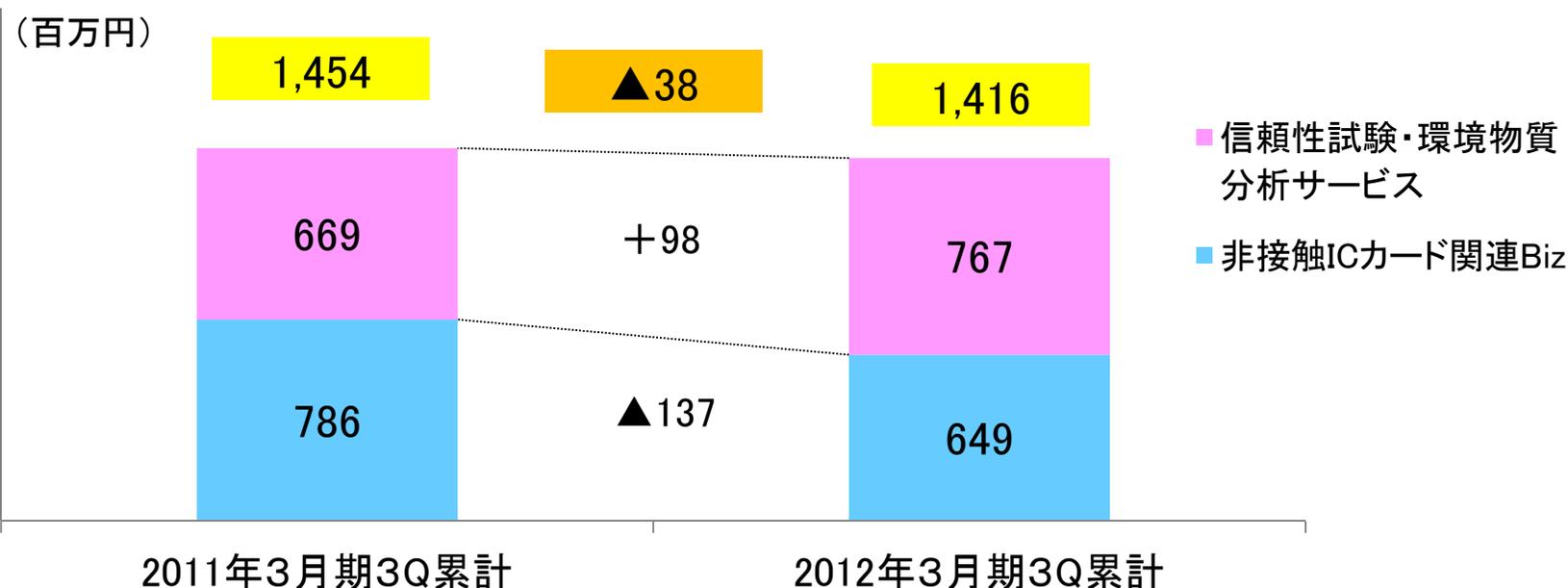
セグメント利益(百万円)

60

▲25

- 業務用電子機器ビジネス: 震災で調達が遅滞していた放送用テープメディアの売上は回復しつつあるものの上期のロスをカバーできず。プロダクション等一部顧客の設備投資延伸もあり、前年比減
- イメージセンシングビジネス: 震災及びタイ洪水の影響による商品供給減と半導体製造装置メーカー向けの販売減により低調
- メディカルビジネスが伸長、将来のビジネスの柱として期待

2012年3月期 第3四半期 システム機器事業



セグメント利益(百万円)

17

122

- 非接触ICカード関連ビジネス
 - ・パソコンへのFeliCaモジュール搭載は減少
 - ・自社開発製品の売上も、震災影響による一部顧客の投資案件延伸等により伸び悩み
- 半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス
 - ・引き続き、試験数、新規案件は増加傾向
 - ・タイ洪水影響によるスポット試験受注も業績に貢献



2012年3月期 第3四半期 財政状態(バランスシート)

(単位:百万円)		11/3月末	11/12月末
現預金		14,753	13,012
売上債権		69,763	58,297
棚卸資産		19,865	16,128
その他		4,280	2,774
流動資産計		108,661	90,213
固定資産計		5,250	4,823
総資産		113,912	95,036

仕入債務		46,484	32,828
短期借入金※		19,251	15,042
その他		3,360	2,577
流動負債計		69,097	50,449
長期借入金		4,515	4,873
その他		1,604	1,222
固定負債計		6,120	6,095
純資産		38,694	38,491

自己資本比率	33.0%	39.8%
---------------	--------------	--------------

※ 1年内返済予定の長期借入金を含む

	前期末比	主な増減要因
総資産	▲18,876	<ul style="list-style-type: none"> ・売上債権 ▲11,466百万円 ・棚卸資産 ▲3,736百万円 ・現預金 ▲1,740百万円
負債	▲18,672	<ul style="list-style-type: none"> ・仕入債務 ▲13,656百万円 ・短期借入金 ▲4,208百万円
純資産	▲203	<ul style="list-style-type: none"> ・四半期純利益 1,717百万円 ・利益剰余金からの配当 ▲560百万円(少数株主への支払含む) ・その他の包括利益累計額の変動額 ▲947百万円 ・少数株主持分の変動額 ▲450百万円
自己資本比率	+6.8%	総資産圧縮により33.0%から39.8%に改善

2012年3月期 第3四半期 財政状態(キャッシュ・フロー)

(百万円)	11年3月期 第3四半期	12年3月期 第3四半期	主な増減要因
営業 CF	▲12,860	▲2,964	<ul style="list-style-type: none"> ・売上債権の減少 10,259百万円 ・税金等調整前四半期純利益 3,066百万円 ・仕入債務の減少 ▲12,255百万円 ・たな卸資産の増加 ▲2,533百万円 ・法人税等の支払額 ▲1,699百万円
投資 CF	762	5,878	<ul style="list-style-type: none"> ・サムスン半導体事業譲渡による収入 5,776百万円 ・定期預金の払戻しによる収入 1,260百万円 ・投資有価証券の売却による収入 607百万円 ・定期預金の預入による支出 ▲990百万円 ・有形固定資産の取得による支出 ▲501百万円 ・子会社株式の取得による支出 ▲280百万円
財務 CF	18,402	▲3,773	<ul style="list-style-type: none"> ・運転資金のための短期借入金 of 減少 ▲3,168百万円 ・配当金の支払額(少数株主への支払含む) ▲560百万円
現金及び 現金同等物	15,871	12,182	

2012年3月期 通期連結業績予想修正

(単位:百万円)	11年3月期通期実績①		12年3月期通期予想② (2011/5/13公表)		12年3月期通期予想③ (2012/2/8公表)		前年同期比 ③/①	予想比 ③/②
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	増減率	増減率
売上高	303,585	100.0%	270,000	100.0%	256,000	100.0%	▲15.7%	▲5.2%
売上総利益	16,314	5.4%	15,000	5.6%	16,450	6.4%	+0.8%	+9.7%
SGA	11,883	3.9%	11,400	4.2%	11,300	4.4%	▲4.9%	▲0.9%
営業利益	4,431	1.5%	3,600	1.3%	5,150	2.0%	+16.2%	+43.1%
経常利益	3,861	1.3%	3,300	1.2%	4,600	1.8%	+19.1%	+39.4%
当期純利益	2,314	0.8%	2,000	0.7%	2,350	0.9%	+1.5%	+17.5%

- 3Q累計は、サムスン半導体・電子部品の事業譲渡や震災・洪水の影響で売上は減少したものの、高付加価値の半導体・電子部品事業の商品が好調に推移したことから、期初の利益予想を大きく上回る進捗率で推移
- 4Q以降の電子部品市場は、欧州債務問題、新興国景気減速等による景気の先行き不透明感はあるものの、タイ洪水の影響が終息に向かっていることから需要の回復が見込まれる
- 当社においても、洪水被害の終息に伴い、デジタルスチルカメラ向けの受注が回復傾向にあることやスマートフォン向け電子部品の販売が引き続き好調に推移する見込であることを踏まえ、通期連結業績予想を修正
- 期末配当金予想: 1株あたり35円



株式会社 UKCホールディングス

〈お問い合わせ先〉

経営企画部 大澤

Mail to: ir@ukcgroup.com

本プレゼンテーション資料中のデータや将来予測は、資料作成時点における当社の判断や入手可能なデータに基づくもので、今後様々な要因によって変化することがあり、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。

